





SmartBeat™DA14195 低功耗外设音频解决方案 让您无论身在何处都能沉浸享受绝美音质

随着高质量在线流媒体的兴起,耳机已经不再单纯是一种配件了,它们成为了重要的娱乐硬件。 Dialog 的 SmartBeat™ DA14195 为实现内置音频处理的有源头戴式耳机提供了一种简单途径。基于行业标准 IP,这款强大的 SoC 使头戴式耳机能够控制环境噪声和增强音质,让用户无论身在何处都能享受"沉浸式"的聆听体验。

DA14195 是一个针对高端有源头戴式耳机的开放音频平台,它采用小尺寸封装,却集极低功耗与超高处理性能于一身。它能帮助您开发外观漂亮并具有顶尖性能(如环境噪声/回声消除、虚拟环绕声和语音控制)的头戴式耳机。同时它最多可支持 6 个麦克风,适合波束成形和位置感知应用。它还能够处理高端音频信号(如 192 kHz 的 32 位 PCM 信号),以提供最极致的声音质量。

应用案例

- ▶USB、蓝牙和/或模拟有源头戴式耳机
- ▶USB 和/或蓝牙头戴式耳机
- ▶位置感知应用(如台式电话)

主要优势

- ▶可以消除环境噪声
- ▶支持高语音质量
 - ▶降噪
 - ▷语音增强
 - ▶回声消除
- ▶支持高端音频,如 192kHz的 32 位 PCM
- ▶支持语音控制,实现无需手动操作的电话呼叫





高效的处理能力

SmartBeat DA14195 集成了高效的 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器,以及支持 C 语言编程的 32 位 Cadence (Tensilica) HiFi 3 DSP (数字信号处理器)。此组合可确保实现小尺寸和低功耗的解决方案,并满足高端头戴式耳机的所有性能要求,提供卓越的音频质量和环境噪声消除功能。同时,MCU 可动态调频,以进一步降低功耗,同时 DSP 还具有广泛的第三方音频算法支持。

灵活的内存架构

DA14195 的共享内存架构包含板载高速缓存、系统 RAM 和 DSP RAM。为提供最大设计灵活性,MCU 代码 (本地执行)和 DSP 代码都存储在外部 QSPI Flash 存储器中,因此您能够按照您的应用需求调节内存成本。

多功能的电源管理

凭借其集成的步降转换器,DA14915 可直接由 USB 或 1.9-5 V 电池供电。高精度电量计可最大限度延长电池 续航时间,并意味着用户可以始终知道其音乐还能播放多长时间。同时,无论产品被放在货架上有多长时间,无电电池唤醒功能可确保显示屏正常工作,所以购买者可以轻松识别是产品电池没电了,还是质量有问题。

易于使用的连接功能

借助 DA14195,您可以创建音频解决方案,使得消费者能够以他们喜欢的方式将设备连接至个人和在线内容库。它带有一个支持 USB 充电规范 1.2 的 USB 2.0 FS/HS 端口,同时提供高达 480 Mbps 的数据传输速率,以保证卓越的语音和音乐质量,并且完全兼容 USB 3.0 type C(下一代智能手机连接选项)。另外,DA14195 还支持两种不同的主机控制器接口(HCI)时钟控制方案。

因此您能轻松地将其与您选择的蓝牙 HCI 相结合,以创建极具吸引力的无线应用。





模块化和开放式软件架构

DA14195 的架构设计可实现超多功能和易于扩展的软件平台。它可提供您需要的所有构块和灵活性,帮助您创造独具特色的解决方案。电源管理是核心要素,灵活的音频 API 则支持您独立创建多路数据流。软件源代码是公开的,以便您实现完全的定制。为最大限度地保证灵活性和可定制性,我们提供强大但且紧凑的嵌入式开发工具包。另外,Dialog 和第三方合作伙伴还提供许多编解码器、声音增强和其他音频组件。

完整的系统解决方案

DA14195 是一个开放式音频平台,可与任何音频编解码器相结合,以创建高端数字应用,如头戴式耳机和头戴式耳麦。它也是 Dialog DA7217 的完美搭档,此款先进的编解码器提供卓越的功率/性能比,并包括语音触发功能,可唤醒 DA14195,以便开始命令识别。







主要优势和特点

- ▶ 用于蓝牙、USB 和模拟头戴式耳机的单一协处理器平台
- ▶ 32-位 ARMCortex-M0 MCU,最大工作频率 165MHz
- ▶ 32-位 Cadence (Tensilica) HiFi 3 DSP, 最大工作频率 290MHz
- ► USB2.0 HS/FS 接口(兼容 USB 3 typeC)
- ▶ 针对蓝牙集成的多种 HCI 时钟控制方案
- ▶ 三重立体声硬件采样率转换器,最大工作频率 192kHz
- ▶ 双路输入 10-位 ADC
- ▶ 支持外部 QSPI Flash 存储器
- ▶ 适合锂离子和锂聚合物电池的集成电池管理
- ▶ 高精度电量计
- ▶ 无电电池唤醒
- ▶ 广泛的数字音频接口(SPDIF、PDM、SPI、UART、I2C等)
- ► 小尺寸 81 焊球 0.4-mm 晶圆级芯片规模封装(WLSCP)

Dialog 半导体公司销售处www.dialog-semiconductor.com email: info@diasemi.com

日本 新加坡

电话:+31 73 640 88 22 电话: +44 1793 757700 电话: +81 3 5425 4567 电话: +65 648 499 29

德国 北美 台湾 香港

电话:+49 7021 805-0 电话:+1 408 845 8500 电话: +852 3769 5200 电话: +886 281 786 222

电话: +82 2 3469 8200 中国(深圳)

电话:+8675529813669

中国(上海)

韩国

电话: +86 21 5424 9058

本出版物仅提供概要信息,未经 Dialog 半导体公司同意,禁止对这些信息进行任何用途的使用、应用或复 制,或视之为有关产品的陈述。标准供应条款请参见公司网站(www.dialog-semiconductor.com)。 Dialog 半导体公司 2016 年版权所有。保留所有权利。 0116HPVC

